

日月光一〇五年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 105 年 10 月 27 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇五年度第三季獲利報告，本公司一〇五年第三季之合併營業收入較一〇五年第二季成長 16%，較一〇四年同期下滑 0.1%，為新台幣 72,784 百萬元。茲將日月光一〇五年度第三季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第三季	105 年度 第二季	104 年度 第三季	105 年度 前三季	104 年度 前三季
營業收入淨額	72,784	62,601	72,870	197,756	207,754
營業毛利	14,113	12,255	12,987	37,817	36,866
營業淨利（淨損）	7,438	5,931	6,382	18,575	18,083
稅前淨利（淨損）	6,875	6,122	7,810	18,372	18,716
所得稅利益（費用）	(976)	(1,523)	(1,127)	(3,817)	(3,579)
非控制權益	(393)	(271)	(315)	(839)	(648)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	5,506	4,328	6,368	13,716	14,489
基本每股盈餘(新台幣元)	0.72	0.57	0.83	1.79	1.89
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.64	0.47	0.69	1.50	1.76

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	105 年度 第三季	105 年度 第二季	104 年度 第三季	105 年度 前三季	104 年度 前三季
營業收入淨額	43,006	38,504	39,862	117,053	116,138
營業毛利	10,969	9,561	10,651	28,362	30,150
營業淨利（淨損）	6,193	4,957	5,644	14,372	16,291
稅前淨利（淨損）	6,319	5,650	7,433	16,434	17,892
所得稅利益（費用）	(719)	(1,266)	(1,016)	(2,514)	(3,262)
非控制權益	(94)	(56)	(49)	(204)	(141)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	5,506	4,328	6,368	13,716	14,489

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	53
電腦	12
汽車，消費性電子及其它	35
前十大客戶佔營收比重	50

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	33
IC Wirebonding	57
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	112 百萬美元
打線機台數	15,905 台

測試業務產品組合	%
後段測試	75
晶圓測試	21
前段測試	4
測試資本支出金額	57 百萬美元
測試機台數	3,725 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	51
電腦	16
消費性電子	20
工業用	7
汽車電子	5
其它	1
前十大客戶佔營收比重	90
EMS 資本支出金額	10 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2016 年第四季的業績展望如下：

- 半導體封測事業產能將較前季持平
- 半導體封測事業利用率將較前季下滑零到百分之五
- 半導體封測事業毛利率將與前季相仿
- 電子代工服務產能將較前季持平
- 電子代工服務產能利用率將較前季成長百分之十到百分之十五
- 電子代工服務毛利率將與 2016 年前半年之毛利率相仿